

OUTLET FLOW CONTROL DEVICE AND SUBSTRATE TREATMENT APPARATUS PROVIDED WITH THE SAME

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 研磨パッド等が配置される処理空間内の所定の場所の温度を一定範囲内、例えば研磨レートが最大となる温度範囲内にすることである。

【解決手段】 本発明の基板処理装置１は、CMP装置１０と、CMP装置１０が配置される研磨空間２０を排気可能に構成された排気流量制御装置３０とを有している。排気流量制御装置３０は、第１の排気ライン３１ａと、第１の排気ライン３１ａにおける排気流量を調節可能な第１の排気流量可変装置３２ａと、第１の排気流量可変装置３２ａを制御するための排気制御部３３とを備えている。排気制御部３３は、CMP装置１０の所定の場所、例えば研磨パッド１４上の温度を一定の範囲内とするために必要な、予め算出された排気流量の制御データを格納した記憶装置を有し、この制御データに基づいて第１の排気流量可変装置３２ａを制御する。

【選択図】 図１